

证券代码：688797

证券简称：臻宝科技

公告编号：2026-009

重庆臻宝科技股份有限公司

关于募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金 进行阶段性现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **募投项目实施周期：**根据重庆臻宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行并上市相关规划，公司募投项目拟分三至四年投入。

● **阶段性现金管理方案：**不超过人民币 100,000 万元(含本数)，该额度是闲置募集资金(含超募资金)阶段性现金管理上限金额，随着募集资金按计划投入募投项目建设，募集资金现金管理金额会相应减少。

● **投资种类：**安全性高、流动性好、满足保本要求的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等)，可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。

● **已履行的审议程序：**公司于 2026 年 8 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项出具了明确同意的核查意见。

● **特别风险提示：**尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但该产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况

根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	81,061.32	75,185.06
2	臻宝科技研发中心建设项目	30,274.42	28,166.56
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	17,000.68	16,400.68
合计		128,336.42	119,752.30

（一）半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目

本项目总投资 81,061.32 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 75,185.06 万元，各项具体投资金额及比例如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金额
1	工程建设费用	75,834.53	69,958.27
1.1	土地购置费	3,640.02	3,640.02
1.2	场地建造及装修费	19,606.14	15,165.65
1.3	软硬件购置	52,588.37	51,152.60
2	基本预备费 2%	1,516.69	1,516.69
3	铺底流动资金	3,710.10	3,710.10
合计		81,061.32	75,185.06

本项目拟在重庆市开展相关工作。项目建设期为 4 年，项目开展将按照土地购置、场地建造及装修、设备购置安装及调试、人员调配及培训和投入生产进度来安排，具体如下表：

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36	T+42	T+48
土地购置								
场地建造及装修								
设备购置及安装								
人员调配及培训								
投入生产								

注：T 代表项目开始时点

截至本公告出具日，公司于 2022 年 6 月 30 日与重庆西彭工业园区管委会、重庆铝产业开发投资集团有限公司签署《重庆臻宝实业有限公司半导体新材料研发制造项目投资协议》。公司已陆续完成部分厂区的建设及装修，同步开展生产设备采购与安装调试工作；三期生产基地 A 厂区已正式投入使用，B 厂区建设装修工作稳步推进。项目建成后，将进一步扩充公司精密零部件加工及表面处理产能。

（二）臻宝科技研发中心建设项目

本项目总投资 30,274.42 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 28,166.56 万元，各项具体投资金额及比例如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金额
1	工程建设费用	18,508.50	16,400.64
1.1	土地购置费	384.00	384.00
1.2	场地建造费及装修费	4,329.00	4,329.00
1.3	软硬件购置费用	13,795.50	11,687.64
2	研发费用	11,172.31	11,172.31
2.1	研发人员工资	5,969.31	5,969.31
2.2	其他研发费用	5,203.00	5,203.00
3	基本预备费 2%	593.61	593.61
合计		30,274.42	28,166.56

本项目拟在重庆市开展相关工作。项目建设期为 3 年，项目开展将按照土地购置及建造装修、设备购置安装及调试、人员调配及培训和产品技术研发进度来安排，具体如下表：

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36
土地购置及建造装修						
设备购置及安装						
人员调配及培训						
产品技术研发						

注：T 代表项目开始时点

截至本公告出具日，公司已完成部分研发方向的项目立项、设备进场与安装调试及人员配置；半导体刻蚀设备用静电卡盘、特殊涂层材料及涂层技术等研发项目正处于关键研发攻坚阶段。

（三）上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目

本项目总投资 17,000.68 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 16,400.68 万元，各项具体投资金额及比例如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金
1	工程建设费用	9,143.66	8,543.66
1.1	场地租赁费	318.66	318.66
1.2	场地装修费	600.00	0.00
1.3	软硬件购置费	8,225.00	8,225.00
2	研发费用	7,523.68	7,523.68
2.1	研发人员工资	3,845.68	3,845.68
2.2	其他研发费用	3,678.00	3,678.00
3	基本预备费 2%	333.34	333.34
合计		17,000.68	16,400.68

本项目拟在上海市开展相关工作。项目建设期为 3 年，项目开展将按照场地租赁、场地装修、软硬件购置安装及调试、人员调配及培训和产品技术研发进度来安排，具体如下表：

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36
场地租赁						
场地装修						
软硬件购置安装及调试						
人员调配及培训						
产品技术研发						

注：T 代表项目开始时点

截至本公告出具日，公司已完成上海研发中心场地租赁及装修工作。ESC 静电卡盘高精密加工与掩膜喷砂技术、TCP Windows 特殊涂层、氮化铝加热盘等研发方向已完成立项，同步开展研发设备采购、安装调试及人员配置，相关项目已步入关键研发攻坚阶段。

二、闲置募集资金进行阶段性现金管理方案概述

（一）现金管理目的

根据公司募投项目整体实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。为优化资金管理、提升短期财务收益，公司将科学合理地

对闲置募集资金进行阶段性现金管理，提高募集资金使用效率，不影响公司募投项目的正常进行。

（二）现金管理金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行超募资金）进行阶段性现金管理，募集资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。公司拟使用募集资金不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行超募资金）进行现金管理，具体资金来源如下：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,882.2600 万股，每股发行价格为人民币 44.56 元，募集资金总额为人民币 172,993.51 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,516.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 160,477.08 万元。

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为 40,724.78 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 6 月 18 日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（四）现金管理方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，且产品期限不超过一年。

2、实施方式

现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。董事会授权公司经营管理层在上述有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择符合资格机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或者协议、开立或者注销产品专用结算账户等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、收益分配方式

募集资金现金管理所获收益归公司所有并视同募集资金进行专项管理。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金的监管要求管理和使用募集资金。

4、信息披露

公司将依据上海证券交易所和中国证监会的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行。

三、审议程序

公司于 2026 年 8 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行超募资金）进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2026 年 8 月 6 日起至 2027 年 8 月 5 日。在使用授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

四、风险分析及风控措施

（一）现金管理风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

- 1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的现金管理产品。
- 2、公司现金管理产品不得用于证券投资、衍生品投资。上述投资产品不得用于质押。
- 3、公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 4、公司审计委员会有权对现金管理资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、闲置募集资金进行阶段性现金管理对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。

六、中介机构意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上，保荐人对公司募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的事项无异议。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日